证券代码：688380　　证券简称：中微半导

中微半导体（深圳）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者来访类别	☑ 特定对象调研　☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访　☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会　☑ 路演活动 ☐ 现场参观　☐ 其他 （线上调研）
参与单位名称	中信证券、美银证券、锦田投资、中保投资、辰星投资、中金富泰、富安时代、北京世纪金沙江、环球港湾、蓝海基金、招商证券 BARCLAYS；ARTISAN PARTNERS LP；COLORADO PERA；POLAR CAPITAL LLP；SCGE MANAGEMENT LP；WALLEYE CAPITAL(UK) LIMITED
时间	2024年3月8日、12日
地点	公司、策略会现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：吴新元
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司基本情况、产品市场和未来发展情况** 公司是一家以MCU为核心的平台型芯片设计公司，专注芯片设计、研发与销售，采取Fabless模式经营，将所有的晶圆生产、大部分封装测试业务委外代工进行；公司主要产品包括8位及32位MCU、SOC、ASIC等芯片和功率器件，产品广泛应用于消费电子、家用电器、工业控制和汽车电子等领域；公司行业地位逐步提升，产品出货量逐年攀升，2023年出货量近18亿颗，创造历史新高；随着高成本库存的消耗和市场需求复苏，去年四季度以来，公司出货量持续上升，产品毛利率触底反弹，公司盈利能力增强。 公司始终坚持以MCU为核心，围绕智能控制器所需核心芯片，打造包括MCU、信号链、电源、通信、功率驱动、软件算法等完整的设计能力，力求为智能控制器提供一站式整体解决方案；坚持两手抓，一手抓高强度研发投入，积极布局新产品研发、老产品迭代和新领域拓展，一手抓品质流程和品牌建设，产品应用坚定不移从小家电向大家电发展、从消费电子向

工业控制和汽车电子迈进，客户结构从小客户向品牌大客户转变，逐步巩固和扩大行业优势。

由于国家的产业政策支持,产品市场空间广阔,公司管理层对公司的长期发展前景看好。

二、交流问答

1、公司一季度情况和年度预期如何？

答：公司持续去年四季度以来的增长势头；随着消费需求复苏、国家产业政策的刺激、公司高库存产品的有效消耗和新产品的推出，2024 年公司营收和盈利可望实现增长。

2、公司上年度销售量达到 18 亿颗，说明公司市占率得到提升，请拆分一下产品结构？

答：我们按照 MCU、ASIC 和功率器件来拆分，2023 年的 18 亿颗出货量中，MCU 近 14 亿颗、各类 ASIC 芯片大概 3 亿颗、功率器件近 1 亿颗，而 MCU 中 8 位机 12 亿多颗、32 位机 1 亿多颗。

3、公司车规级产品研发和推广情况如何？

答：汽车电子市场是公司布局的重要发展方向。车规级产品的研发也是公司重要的募投项目，去年公司车规级产品研发得到有效实施，多款车规级产品实现量产，车规产品阵列得到扩充，产品更加丰富，目前量产料号有 20 多款；通过一年多的推广，去年下半年以来，车规级产品实现稳定批量出货，期待今年车规级产品的营收有较大的突破；同时公司已经通过了 SGS 的 ISO 26262 的安规认证，标志着建立了符合汽车功能安全最高等级“ASIL-D” 级别完整的产品开发流程体系，助力公司未来在汽车电子领域高质量发展。

4、公司一直注重测量类产品的研发，目前市场推广情况如何？

答：公司高精度测量类产品从性价比方面还是具有优势的，通过去年的推广，已经取得一些市场突破。新年度，这方面的增长值得期待。

5、谈谈公司电机控制业务发展情况？

答：电机控制是 MCU 的一个重要应用方向，公司 2018 年布局电机控制产线，提供包括主控 MCU、驱动和电机控制算法一体的解决方案。自 2019 年该产线实现营收以来，该产品线稳步增长，成为公司的第三大营收产

	线。去年公司推出了多款电机 SOC 产品，电机应用团队得到充实，团队服务能力有较大提升，预计今年该产线的业绩会有较大增长。 **6、公司主要代工厂商？** 答：公司晶圆代工主要在华虹半导体和格罗方德公司，封测代工主要在华天科技、华润安盛、利扬芯片、伟测科技等。 **7、晶圆代工厂选择的原则？** 答：首先看厂方的工艺是否满足产品性能、品质要求，其次是看性价比。 **8、公司产品料号有多少？** 答：公司产品累计料号有 1200 多个，在售料号 600-700 个。 **9、经销和直销占比？** 答：从营收来看，6 成营收来自经销，4 成来自直销。 **10、公司的 ASIC 芯片有哪些？** 答：主要有高精度 ADC、显示驱动、栅极驱动、电机驱动、触摸、线性稳压器等芯片。